



**关于广东利扬芯片测试股份有限公司
向特定对象发行股票的
审核中心意见落实函的回复**

保荐机构（主承销商）



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二二年三月

上海证券交易所：

贵所于 2022 年 2 月 24 日出具的上证科审（再融资）〔2022〕31 号《关于广东利扬芯片测试股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称“落实函”）已收悉，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”、“发行人”、“公司”）、中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）对落实函中的相关问题逐项进行了研究和落实，现对落实函问题回复如下，请予审核。

如无特别说明，本落实函回复报告中的简称或名词的释义与《广东利扬芯片测试股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》中的相同。

本回复报告的字体代表以下含义：

落实函所列问题	黑体
对落实函所列问题的回复	宋体
对募集说明书的引用	楷体（不加粗）
对募集说明书的修改、补充	楷体（加粗）

目 录

问题 1 请发行人结合本次募投使用场地面积 明确本次募投项目拟使用的募集资金，调整不属于本次募投项目的募集资金	4
---	---

问题 1 请发行人结合本次募投使用场地面积,明确本次募投项目拟使用的募集资金,调整不属于本次募投项目的募集资金。

回复:

一、结合本次募投使用场地面积,明确本次募投项目拟使用的募集资金

东城利扬芯片集成电路测试项目总投资额为 131,519.62 万元,包含基础设施建设 8,054.76 万元,设备购置及安装费 113,236.50 万元,工程建设其他费用 252.19 万元,预备费用 6,077.17 万元,铺底流动资金 3,899.00 万元。

经公司第三届董事会第四次会议、2021 年第三次临时股东大会、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第八次会议审议通过,本次募投项目拟使用募集资金投资金额为 125,702.60 万元。本次新建厂房涉及部分面积系预留用于公司未来提高产能和测试技术,该部分所涉及的建设费用公司将通过自筹资金投入。本次募投项目投资金额具体如下:

单位:万元

资金投入类别	投资金额	使用募集资金投资金额
基础设施建设	8,054.76	3,489.93
设备购置及安装费	113,236.50	113,236.50
工程建设其他费用	252.19	-
预备费	6,077.17	6,077.17
铺底流动资金	3,899.00	2,899
项目总投资	131,519.62	125,702.60

本次募集资金投资项目将新建 25,572 平方米厂房,相关基础设施建设费用总额为 8,054.76 万元。其中,11,077 平方米厂房将用于公司本次扩产使用,相关基础设施建设费用为 3,489.93 万元,公司拟使用募集资金投入;另有 14,495 平方米厂房预留用于未来提高产能和测试技术,相关基础设施建设费用为 4,564.83 万元,公司拟使用自筹资金投入。同时,新建厂房相关的工程建设及其他费用为 252.19 万元,公司拟全部使用自筹资金投入。本次新建厂房面积、用途及对应的建设费用具体如下:

场地用途		场地面积 (平方米)	对应基础设施建设费用		工程建设及其他费用 ^{注2}	
			金额 (万元)	是否使用本 次募集资金	金额 (万元)	是否使用本 次募集资金
本次扩产	放置新增设备	6,000	1,930.00	是	252.19	否
	仓库	3,000	900.00			
	配套区 ^{注1}	1,700	546.83			
	检验和包装	377	113.10			
	小计	11,077	3,489.93			
后续提高 产能和测 试技术	放置后续新增设备	7,600	2,448.00	否	252.19	否
	后续仓库	4,100	1,230.00			
	后续配套区	2,272	729.93			
	后续检验和包装	523	156.90			
	小计	14,495	4,564.83			
总计		25,572	8,054.76	-	252.19	否

注 1：配套区包括周转区、配件房、烘烤室等；

注 2：工程建设及其他费用包括建设单位管理费及勘察设计费、咨询评估费等其他前期费用。

综上，本次东城利扬芯片集成电路测试项目总投资额为 131,519.62 万元，拟使用募集资金投入金额为 125,702.60 万元，其余 4,817.02 万元系本次新建厂房预留面积相关建设费用和其他费用，公司将通过自筹资金投入。

二、调整不属于本次募投项目的募集资金

2022 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，将本次发行股票的募集资金规模由不超过 135,519.62 万元调整为不超过 130,702.60 万元，其中东城利扬芯片集成电路测试项目拟使用募集资金金额由 130,519.62 万元调整为 125,702.60 万元。调减的 4,817.02 万元系本次募投新建厂房预留面积相关建设费用和其他费用，公司将通过自筹资金投入。

经调整后，公司本次募集资金使用计划具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	东城利扬芯片集成电路测试项目	131,519.62	125,702.60
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		136,519.62	130,702.60

附：保荐机构关于公司回复的总体意见

对本回复材料中的公司回复，本保荐机构均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确。

(本页无正文，为《关于广东利扬芯片测试股份有限公司向特定对象发行股票的
审核中心意见落实函的回复》之签署页)



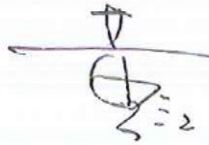
广东利扬芯片测试股份有限公司

2022年3月1日

发行人董事长声明

本人已认真阅读广东利扬芯片测试股份有限公司本次落实函回复的全部内容，确认回复报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事长：



黄江

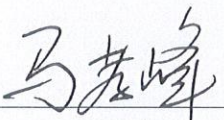


广东利扬芯片测试股份有限公司

2022 年 3 月 1 日

(本页无正文，为《关于广东利扬芯片测试股份有限公司向特定对象发行股票的
审核中心意见落实函的回复》之签署页)

保荐代表人：


马孝峰

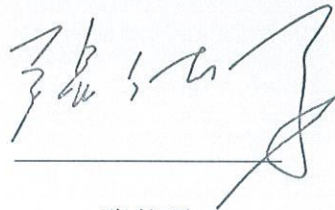

李艳梅



保荐机构董事长声明

本人已认真阅读广东利扬芯片测试股份有限公司本次落实函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：



张佑君

